

YCD02004L

Re-yingcai® 芯片清洗剂是东莞市盈彩新材料科技有限公司专用于半导体制造与电子封装环节的高纯度化学试剂产品，用于去除晶圆、芯片、PCB等表面的光刻胶残留、金属离子（铜、铝）、助焊剂（松香）、硅胶、油墨、三防漆及微颗粒污染物。产品采用科学的配方设计，通过表面活性剂与溶剂协同作用，渗透微米级缝隙，在实现高效清洁的同时不损伤纳米级电路结构与敏感材料。



微粒去除

有效清除表面亚微米级颗粒物，减少图形缺陷，提升良率。



金属捕集

络合吸附金属杂质离子，降低表面残留，保障电性能稳定。



胶膜剥离

快速渗透溶解光刻胶及有机残渣，清洁彻底无遗留。



材质保护

对硅片、氧化层及金属布线腐蚀极低，保护精细图形结构。



超净漂洗

易被去离子水冲洗干净，无残留物，避免二次污染。



绿色合规

不含卤素及重金属，废液处理便捷，满足环保要求。

型号	YCD02004L
比重（ 20℃ ）	1.00 – 1.10 g/cm ³
表面张力	≤25 mN/m
粘度（ 25℃ ）	1 – 10 cP
闪点	>60℃
沸点	>100℃
腐蚀速率	腐蚀速率
腐蚀速率	≥95%
操作温度	建议低于75℃
使用浓度	可原液使用或按需稀释
适用基材	硅晶圆、铜互连、低k介质、PCB等
包装规格	25kg/桶(可按需定制)